



产品规格书/Specification

产品/product:	导电铜浆/ Copper paste
料号/Part number:	25H-1805

适用范围/Application:

This Specification applies to ceramic capacitor conductive paste.
此产品适用于陶瓷电容类产品铜电极使用。

使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	陶瓷类材料 Ceramic
印刷 Printing	200-300 目丝网印刷 200-300 mesh stainless screen
流平 Levelling	5-15min minutes at room temperature 室温下流平 5-15 分钟（时间根据流平的实际情况决定）。
干燥 Drying	通风烘箱烘烤 100-150℃，10-15 分钟 （烘烤温度低于 300℃，可根据烘烤的实际情况决定烘烤时间。） 100-150℃ 10-15 min
烧结 Firing Condition	隧道炉氮气保护气氛下烧结，峰值 830±10℃（推荐值），10-20 分钟。 （可根据实际需要，烧结范围可在 800-850℃内调节,但峰值温度时间必须至少 10 分钟。一般来说，高温烧结后陶瓷电容性能优于低温烧结）
Thinner	ST-1000

性能/Characteristics:

1. 浆料性能/Paste Characteristics:

性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1 Fineness	≤5μm	FOG test
2 Viscosity	80-280Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT (博利飞) 粘度计, 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。



2. 烧结后特性/Characteristics after firing:

在 1 烧结条件下, 膜厚 8-12 μ m Check fired film produced under the conditions specified in 1), (Film thickness is 8-12 μ m.)

特性 Characteristics	Standard 标准	测试方法和条件 Test method and conditions
3 Resistivity 方阻	$\leq 15\text{m}\Omega/\square$	Test pattern 0.6mm \times 60mm 测试图形 0.6mm \times 60mm
4 Adhesion strength 附着力		Peel Test: 0.5mm ϕ Tin plated Cu wire soldered on 2mm \times 2mm Pad. 0.5mm ϕ 锡浸铜线, 焊接面积 2mm \times 2mm Solder: 96.5Sn/0.5Cu Mildly activated flux used. 焊料: 96.5Sn/0.5Cu
Initial 初始附着力	$\geq 26.2\text{N}$	
Ageing 老化附着力	$\geq 22.6\text{N}$	Ageing: 150 $^{\circ}\text{C}\times$ 24hrs 老化条件: 150 $^{\circ}\text{C}$, 24 小时

保存条件, 有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-25 $^{\circ}\text{C}$ 的环境温度下密封储存, 有效期为产品发货之日起 1 年。

The product shall be guaranteed for 1 year after shipping date, keep tightly under at 5-25 $^{\circ}\text{C}$

包装方式/Packaging method:

标准包装, 1000g/罐, Standard package: 1000g/can,

样品装: 200 克/罐 Sample package: 200g/can